

碳足迹自查报告

根据国家发展和改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求，本报告主体核算了 2023 年度的温室气体排放量，并汇报如下：

一、企业基本情况

沈阳汉科半导体材料有限公司成立于 2006 年，是新加坡汉民科技（私人）有限公司与汉唐控股私人有限公司投资兴建，注册资金 2583.05 万美元，主要从事半导体集成电路生产设备用高纯石英制成品的生产及销售。汉科作为集成电路生产配套的高科技生产企业前景非常广阔。其中中德园工厂项目是 2020 年备案建设，并于 2021 年逐步试运行投产。

公司生产产品主要安装在集成电路生产工艺设备上，涉及 12 寸、8 英寸、6 英寸及以下等集成电路生产机台，做为硅片的承载器及反应腔，为芯片制造提供一个高纯高温的洁净环境，其中我司生产的舟类产品更是直接与硅片接触，对芯片品质有着至关重要的影响，所以是集成电路制造不可缺少的核心零部件。公司先后通过了国际知名半导体机台制造商 TEL 及 KE 的相关认证，拥有 8 英寸、12 英寸及 TEL 超高纯产品生产资质，是国内三家拥有该资质之一。

2021 年荣获省级瞪羚企业、市级企业技术中心、省级专精特新产品、省级高新技术企业。2022 年荣获省级实质性产学研联盟、省级企业技术中心、辽宁省“专精特新”中小企业。

二、温室气体排放

我公司为石英玻璃制品制造生产企业，我公司产生温室气体的主要途径为外购入电力和热力。经核算，2023年我公司的碳排放总量为 11132tCO₂。

补充数据	2023	计算方法或填写要求
1 二氧化碳排放总量 (tCO ₂)	11132	1.1 和 1.2 之和
1.1 净购入电力对应的排放量 (tCO ₂)	6230.27	按核算与报告指南公式计算
1.2 消耗热力对应的排放量 (tCO ₂)	4902.15	按核算与报告指南公式计算
2 主营产品产量 (PC)	29767	优先选用企业计量数据，如生产日志或月度、年度统计报表,其次选用报送统计局数据
3 主营产品产值 (万元)	22443	
4 单位产品碳排放量 (tCO ₂ /PC)	0.37	二氧化碳排放总量/主营产品产量
5 单位产值碳排放量 (tCO ₂ /万元)	0.50	二氧化碳排放总量/主营产品产值

三、活动水平数据

我公司的活动水平数据主要来源能源消耗台账，具体如下：

月份	净购入电力 (MWh)	净购入热力 (GJ)
1 月	434.400	8645
2 月	413.460	12690
3 月	595.020	3582

4 月	734.280	0
5 月	497.880	0
6 月	345.066	0
7 月	294.409	0
8 月	269.749	0
9 月	434.400	0
10 月	413.460	0
11 月	595.020	8048
12 月	734.280	11600
合计	4996.724	44565

四、排放因子数据及来源说明

电力排放因子来源于国家电网排放因子，热力排放因子来源于核算指南。

五、其他需要说明事项

本报告真实、可信。如报告中有与实际不符情况，本公司愿意承担相应的法律责任。

沈阳汉科半导体材料有限公司（中德园工厂）

2024年4月15日

